

证券代码：688783

证券简称： 西安奕材

西安奕斯伟材料科技股份有限公司
投资者活动记录表

编号：2026-07

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☒路演活动 ☐现场参观 ☐其他
参与单位名称及参会人员姓名	光大保德信基金、万兆慧谷、平安资产、深圳创新投资、国投瑞银基金、中欧基金、天风证券、中金公司、从容投资、银叶投资、诚盛投资、鸿商集团、圆信永丰、宏道投资、泓德基金、华夏财富创新、富荣基金、中新融创、信达资本、睿郡资产、正向投资、先锋基金、上海保银投资、Point72、粤信资产、美阳投资、荷和投资、博普科技、中庸资本、泾溪投资、高腾国际、中信里昂、红杉资本、宝新能源、越秀产投、建银国际、兴源投资、恒邦兆丰资管、闻天投资、禹田资本、瀑布资产、万向创投、川流资本、比亚迪财险、比亚迪、九祥资产、浙江伟星资产、鑫盛寰宇、清禾基金、云星澜、中英人寿、 中信证券、宏利基金、银华基金、嘉实基金、大家资产、和谐保险资管 西部证券、泰康资产、国寿资产、新华基金、长盛基金 国金证券、泰康基金、新华资产、长城基金、中金资管 西部利得、江阴米利都私募、上海盘京、金鹰基金、中信建投资管、中邮创业基金、上海歌汝私募、上海相生、上海景领、北京秋收私募、深圳前海华杉、深圳固禾私募、泉果基金、中哲物产集团、Pinpoint、杭州中大君悦、招商证券资管、中加基金、长城财富保险、北京诚盛、深圳鑫然私募、中国银河证券、中加基金、长盛基金、西藏博恩、兴银理财、汇百川、湖南长心私募、伟星、中国宽带产业、腾跃基金、华夏基金、中金基金、路博迈(中国)、上海国泰海通资管、上海冲积、北京鸿道、创金合信基金、博远基金、上海卫宁私募、华夏久盈保险、幸福人寿保险、南方天辰、申万宏源证券、英大保险、北京诚盛、新华养老、招商基金、泉果基金、首创证券、上海盘京、泓德基金、上海胤胜、中邮创业基金、英大基金、中银三星人寿保险、Astroll、北京星石
会议时间	2026 年 08 月 26 日 - 08 月 27 日
会议地点	公司在北京参加了中信证券、西部证券分别组织的反路演和国金证券组织的策略会
上市公司接待人员姓名	市值管理与投资者关系部部长 索子欣 市值管理与投资者关系部经理 刘晗
会议内容	1、请简单介绍一下公司的业务和目前的业绩情况。 答：公司专注于 12 英寸硅片的研发、制造和生产，产品广泛应用于消费电子、汽车制造、AI 等领域所需要的存储芯片、逻辑芯片、图像传感器、显示驱动芯片、电源管

理芯片及 IGBT、Power MOSFET 等功率器件领域。公司产品当前主要布局用于存储芯片和逻辑芯片制造的抛光片和外延片。

经营业绩方面，公司上半年销售量约 500 万片，同比增长约 29.76%，实现营业收入 15.89 亿元，同比增长 22.00%。其中，抛光片实现销售 5.21 亿元，同比增长 16.27%；外延片实现销售 4.88 亿元，同比增长 53.05%；测试片实现销售 5.77 亿元，同比增长 8.61%。受益于公司产品结构持续改善，正片收入占比持续提升，归属于上市公司股东的净利润为-2.89 亿元，较上年同期减亏 14.98%。从季度别上看，公司第二季度较第一季度营业收入同比增长约 20%，归属于上市公司股东的净利润同比收窄约 17%，公司 2026 年业绩及盈利能力呈现逐季增长趋势。

产能建设方面，公司已布局西安和武汉两个基地。其中，西安基地已建成两座工厂，第一工厂不断提升效能，第二工厂正在产能爬坡，位于武汉基地的第三工厂正处于厂房建设阶段，5 月完成主厂房结构封顶。截止 2026 年 6 月，公司产能合计达到 100 万片/月以上，公司出货量全球市占率约 7.7%，位居 12 英寸硅片领域国内第一、全球第六。下半年，公司将持续推进第一工厂效能提升、第二工厂扩产及达产、第三工厂全面建设工作，全力实现 2026 年 12 月第二工厂 50 万片/月产能达产，届时公司将具备约 120 万片/月产能，有望位居国内第一、全球前五。第三工厂预计 2026 年 10 月可提前实现首批设备搬入，2027 年上半年实现首批产能投产，2030 年实现达产，达产后公司总产能将提升至约 180 万片/月以上。

客户拓展方面，公司作为 12 英寸硅片领域出货量国内第一、全球第六的头部企业，已实现国内、海外头部晶圆厂全覆盖，系国内主要存储和代工厂商的第一或第二大供应商。在立足国内市场的同时，公司持续深化全球客户布局，2026 年上半年首次实现 SK 海力士测试片小批量供货，至此公司已实现与三星电子、SK 海力士、台积电、美光科技、铠侠全球头部晶圆厂的合作。此外，公司持续向格罗方德、力积电、联华电子、华邦、南亚科、东芝等全球主流晶圆厂稳定批量供货，并持续推动新产品验证，公司全球化的供应体系与产品竞争力持续提升。

2、请问本轮硅片周期情况如何？从技术路径及发展方向来看，未来硅片的增长动力有哪些？走势会大概持续多久？

答：1、全球半导体产业正处于 AI 驱动的结构性的增长周期。据 WSTS 预测，2026 年行业规模预计达 1.65 万亿美元，同比增长 108.1%，主要受 AI 算力基础设施、高带宽内存（HBM）及数据中心建设的拉动。2026 年，分区域来看，美洲市场增速领先，预计增长约 112%；欧洲和日本市场预计分别增长 58%和 28%；亚太地区增长 87%。从产品结构看，行业规模增长呈现明显分化：存储芯片同比增长 302%，逻辑芯片增长 42%，而模拟、分立器件、传感器等品类增速在 2%-25%之间，AI 相关与非 AI 相关品类的增速差距持续扩大。

受 AI 算力、高带宽内存（HBM）、数据中心强劲需求拉动及消费电子需求复苏影响，AI 芯片、先进逻辑芯片、存储芯片订单持续放量，带动 12 英寸硅片需求高速增长，全球 12 英寸硅片呈现供不应求的态势。根据机构预测，全球 12 英寸硅片 2026 年需求将

超过 1,000 万片/月，未来 5 年复合增长率约为 7%。中国大陆 12 英寸硅片 2026 年需求将达到约 350 万片/月，未来 5 年复合增长率约为 15%。受下游强劲需求带动，2026 年 12 英寸硅片价格触底反弹。

2、（1）新应用特别是 AI 算力、存力及运力对晶圆强劲的需求，将直接带动 12 英寸硅片市场需求持续增长；

（2）先进封装、BSPDN（晶背供电）、3D 堆叠等新器件、新工艺、新技术均需使用“多片堆叠”技术，将提升单位晶圆的硅片耗量，为 12 英寸硅片需求增长带来更大的潜在增长点。

3、请问市场 12 英寸硅片价格未来是否会涨价？公司什么时候与客户进行明年长单的谈价？目前 12 英寸硅片海外头部硅片厂商是否涨价？本轮周期硅片单片平均价格是否会恢复到上一轮周期 ASP 高点水平？预计年底的涨价幅度如何？

答：2022 年至 2025 年硅片行业进入下行周期，价格持续走低，较高点价格下滑 30% 以上，2026 年受 AI 算力、高带宽内存（HBM）、数据中心强劲需求拉动及消费电子需求复苏影响，AI 芯片、先进逻辑芯片、存储芯片订单持续放量，带动 12 英寸硅片需求高速增长，全球 12 英寸硅片呈现供不应求的态势，价格从 2026 年开始逐步复苏。

由于当前强劲的市场需求，公司持续与客户针对不同产品协商涨价，本轮涨价幅度根据不同产品具体情况与客户按照一定区间进行磋商。由于半导体硅片行业长单锁量、锁价的特点，公司 2026 年上半年交付的订单基本在 2025 年末已确定，锁定了产能及出货价格，所以报告期内公司业绩受前述需求及价格上涨因素影响有限。2026 年上半年新增供货产品已实现涨价，大部分涨价订单将于今年四季度签署，锁定 2027 年物量和价格，因此涨价带来的财务业绩将逐步显现。

4、请问公司海外客户验证情况目前是怎样？公司外销销量及金额占比大概是多少？目前公司的海外客户需求量是否有提升？公司的产品技术水平在国际市场上处于什么位置？公司跟海外头部硅片厂商相比，有哪些差距？

答：凭借优异的产品品质与稳定的供应能力，公司立足国内，更放眼全球，已构建起覆盖海内外主流晶圆厂商的客户体系。公司持续向台积电、三星电子、美光科技、铠侠、格罗方德、力积电、联华电子、华邦、南亚科、东芝等客户稳定批量供货并不断进行新产品验证，首次实现格罗方德外延片产品送样、SK 海力士测试片小批量供货，正在推进三星电子、SK 海力士等海外重点客户正片认证工作。

截至 2026 年 6 月底，公司上半年外销金额约占总销售金额的 22.03%，总销量及总金额同比持续提升。目前全球前五大厂商仍是海外主流客户的主要供应商，国内供应商在海外市场占比仍有较大提升空间，公司将依托当前海外客户的供应基础，将提升海外客户供应份额作为公司后续市场开拓的重点工作之一。

公司作为 12 英寸国内头部企业，已形成拉晶、成型、抛光、清洗和外延五大工艺环节的核心技术体系，产品的晶体缺陷控制水平、低翘曲度、超平坦度、超清洁度和外延膜层形貌与电学性能等核心指标已与全球前五大厂商处于同一水平，但整体较海外

头部仍存在一定差距，这是国内硅片行业作为“后来者”发展过程中的阶段现象。具体而言，主要应用于 DRAM、NAND 等存储芯片领域的抛光片产品，基本与海外头部处于同一水平，其中应用于 3D NAND 等产品的抛光片产品，在应用层面与海外持平；主要应用于 CPU、GPU 等逻辑芯片领域的外延片产品，较海外头部仍存在一定差距。

5、请问公司各个工厂固定资产折旧情况是怎样的？大概什么时候是固定资产折旧高峰？未来是否会有新增的资本性开支？第三工厂的设备是否已经开始提前下单预定？

答：2026 年上半年公司固定资产折旧总额为 6.24 亿元，同比增长 11.8%，主要受第二工厂产能持续爬坡影响。2026 年 12 月公司第二工厂达产后公司将进入折旧高峰。

公司第三工厂于 2025 年 12 月开始开工建设，2026 年 5 月已完成主厂房结构封顶，部分交期长的设备已提前进行预定下单，预计 2026 年 10 月可提前实现首批设备搬入，2027 年上半年实现首批产能投产，2030 年前实现达产，达产后公司总产能将提升至约 180 万片/月以上。

6、请问公司在扩产中设备及材料采购是否有风险？目前公司设备的国产化率如何？目前国产设备还比较难被替代的设备都是哪些类型的设备？

答：硅片属于半导体上游环节，受海外限制较少，设备及材料采购方面无明显掣肘。为了提升公司的供应链管控能力及供应链安全，公司持续推进设备和材料的二元化和国产化，设备和材料的自主可控能力持续提升。其中硅片核心设备一晶体生长设备公司目前已完全实现自主可控，并持续迭代升级。但目前在硅片加工的后段工艺设备国产化率较低，例如高端抛光设备、清洗设备及检测设备等仍需依赖进口。

7、目前国内晶圆厂的硅片是否已经完全实现国产替代？国内头部几家硅片厂商陆续都有扩产计划，这样是否会造成未来供应过多，竞争压力变大？

答：在抛光片领域，随着国内存储晶圆厂商的崛起，当前用于存储芯片制造的 12 英寸抛光片国产化比例较高，约占 90%左右，国内硅片企业已实现规模化量产供应。在用于逻辑芯片的 12 英寸外延片领域，海外硅片厂商在高端产品占据主导，海外头部企业已实现 2nm 制程量产，较高的技术壁垒与客户认证周期，仍是国内企业实现突破的核心挑战。

目前 12 英寸硅片需求高速增长，全球 12 英寸硅片供给呈现供不应求的态势，12 英寸硅片产业与下游晶圆厂在产品及技术上是深度协同绑定的。公司目前已布局西安和武汉两个基地，投建三座工厂，2030 年前随着公司第三工厂达产，公司总产能将提升至约 180 万片/月以上。公司作为 12 英寸硅片领域出货量国内第一、全球第六的头部企业，已实现国内、海外头部晶圆厂全覆盖。在此基础上，公司将持续聚焦“品质、技术和性价比”，不断提升产品力、技术力和管理力，稳步实现公司的中远期战略目标。

8、请问公司上半年各产品占比是什么情况？国内头部存储客户产品在公司总营收的占比是多少？公司前五大的客户比较稳定，公司在客户的销售份额是否还有提升空间？

公司对于海外客户三星电子和 SK 海力士的下一步规划是什么？

答：公司上半年销售量约 500 万片，同比增长约 29.76%，实现营业收入 15.89 亿元，同比增长 22.00%。其中，抛光片实现销售 5.21 亿元，营收占比为 33%；外延片实现销售 4.88 亿元，营收占比约为 30%；测试片实现销售 5.77 亿元，营收占比约为 37%，其中高端测试片实现销售 2.89 亿元，营收占比约为 18%。

公司系国内头部存储芯片厂商全球 12 英寸硅片厂商中供货量第一或第二的供应商。为高效响应客户需求，公司设立销售子公司，专门负责公司销售业务，并在战略客户所在城市布局生产基地，从技术、产能等方面，全方位配套客户扩产。

公司 2025 年通过三星电子测试片验证，今年上半年开始向三星电子稳定量产测试片产品，并首次实现 SK 海力士测试片小批量供货，正片持续验证中；公司下半年将继续推进三星电子、SK 海力士等海外客户正片认证工作，持续提升在海外存储客户的供应份额。

9、存储、逻辑及功率芯片，哪一种未来的需求量会提高更快？目前国内晶圆厂的硅片是否已经完全实现国产替代？存储晶圆厂的芯片的硅片消耗量是多少？像存储芯片中的 NAND 产品制作一个晶圆需要多少硅片？国内存储客户扩产计划是什么节奏，硅片的需求量级大概是怎样的？

答：P 型轻掺抛光片主要应用于 DRAM、NAND Flash 等存储芯片的制造，是 12 英寸硅片市场需求量最大的主流产品。随着 AI 带动先进存储器件需求不断增加，多层堆叠技术的持续推动，以及先进封装领域产能的持续增长，P 型轻掺抛光片的需求将持续增长。P 型轻掺外延片市场需求量仅次于 P 型轻掺抛光片。随着 AI 对算力需求的持续增长，先进逻辑以及电源管理等芯片用 P 型轻掺外延片需求将持续增长。

存储客户方面，国产硅片供应份额约占 90%左右，其余从海外硅片厂进口；逻辑客户方面，海外硅片厂商在高端产品占据主导，逻辑客户 12 英寸硅片整体国产化率小于 50%。另外海外头部企业已实现 2nm 制程量产，较高的技术壁垒与客户认证周期，是国内产业链进一步升级的核心挑战。

头部存储厂商的 NAND Flash 产品目前使用 3D 堆叠的技术，主要采用 3D 堆叠结构，单个芯片的堆叠层数越高，则工艺难度和水平越高。除产线机台对于测试片的固定消耗外，后续芯片制造至少需要 2 片以上的硅片进行加工。未来 DRAM 产品将采用 3D 架构，硅片单位消耗量也将进一步提升。未来随着下游客户扩产计划及技术升级的完成，预计存储芯片所需的硅片将持续增长。